

STICLOTEXTOLIT FOTOPOZITIV

1. Descriere generală

Sticlotextolit cu grosimea de 1,5 mm, simplu sau dublu placat cu folie de cupru de 35 μ , cu depunere de lac fotopozitiv protejat cu folie opacă la radiația UV.

2. Caracteristici

Lacul fotopozitiv transferă direct imaginea de pe șablon (desen) pe materialul de lucru, pentru corodare. Lacul este rezistent la produsele de corodare acidă dar poate fi îndepărtat ușor cu solvenți (acetona).

3. Aplicații

Sticlotextolitul fotopozitiv se utilizează la fabricarea circuitelor imprimate simplă și dublă față. Partea transparentă a desenului este insolată cu acuratețe. Suprafețele opace la lumină rămân după corodare.

4. Instrucțiuni de utilizare

a. Expunere

După îndepărtarea foliei de protecție desenul circuitului imprimat se așază perfect plan pe fața cu cupru. Sensibilitatea spectrală a lacului fotopozitiv este în domeniul 340 - 420 nm, astfel încât la expunerea ansamblului desen/sticlotextolit fotopozitiv trebuie utilizată o lampă UV.

Practic se recomandă o preîncălzire a lămpii de cca. 3 minute. Timpul de expunere se alege în funcție de puterea lămpii și distanța de la ea la ansamblul de insolat și este de 3-5 minute.

b. Developare

Placa expusă se dezvoltă prin imersie în soluție de hidroxid de sodiu în apă (7-10 g/l) la temperatura ambiantă (20-25°C) timp de aproximativ 2 minute. Partea expusă la UV se dizolvă în soluție. Este indicată o ușoară agitare a plăcii în timpul dezvoltării. După dezvoltare placa se clătește cu apă.

c. Corodare

Pentru corodare se recomandă o soluție de clorură ferică cu concentrația de aproximativ 40% la o temperatură de cca. 50°C cu agitare (barbotare) permanentă. La terminarea corodării circuitul imprimat se spală abundant cu apă.

d. Îndepărtarea lacului rămas pe cupru

Lacul rămas pe circuit după corodare se îndepărtează cu acetona la temperatura ambiantă.

Recomandare: După realizarea circuitului imprimat este bine să se aplice un strat de Flux SK10 care protejează cuprul împotriva oxidării și constituie un flux foarte eficient pentru lipirea componentelor.

Măsuri de protecție

Operațiile prezentate mai sus se efectuează numai în încăperi foarte bine ventilate și utilizând haine, mănuși și ochelari de protecție.